

机械设备行业跟踪周报

看好半导体设备超级景气周期&资本开支加速受益的 AI 设备; 推荐估值低稳增长的工程机械

增持（维持）

2026 年 08 月 02 日

证券分析师 周尔双

执业证书: S0600515110002

021-60199784

zhouersh@dwzq.com.cn

证券分析师 李文意

执业证书: S0600524080005

liwenyi@dwzq.com.cn

证券分析师 韦译捷

执业证书: S0600524080006

weiyj@dwzq.com.cn

证券分析师 黄瑞

执业证书: S0600525070004

huangr@dwzq.com.cn

研究助理 陶泽

执业证书: S0600125080004

taoz@dwzq.com.cn

1.推荐组合: 北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。

2.投资要点:

【半导体设备】海外半导体设备业绩验证 AI 测试需求高景气，继续看好国产设备商海外半导体设备业绩持续超预期兑现。1、爱德万 FY26Q1 营收 3675 亿日元(约 152 亿元人民币)，同比 +39%; 净利润 1748 亿日元(约 72 亿元人民币)，同比 +94%。2、TEL FY26Q1 度营收 7324 亿日元，同比 +33%; 净利润同比 +40%。3、LAM FY26Q4 营收 67.2 亿美元，同比 +30%; 净利润 22.8 亿美元，同比 +32%。AI 驱动海外半导体设备高景气，国产设备将受益于行业 bbeta&国产替代双重逻辑。海外 AI 加速海外玩家业绩兑现，我们认为，AI 驱动下国产算力将快速发展，带来先进制程、先进封测设备新需求，不管是先进逻辑还是长存、长鑫等先进产能都在积极扩产; SoC 芯片设计和制造的复杂性大幅增加，对测试机提出更高要求; COWOS、HBM 等先进封装技术快速发展。投资建议: (1) 前道制程: 刻蚀+薄膜沉积设备北方华创、中微公司、迈为股份、量测设备中科飞测、精测电子、薄膜沉积设备拓荆科技、微导纳米、晶盛机电等。(2) 后道封测: 长川科技、华峰测控。(3) 先进封装: 拓荆科技(键合机)、华海清科(减薄机)、盛美上海(电镀机)、芯源微(涂胶显影+键合机)、迈为股份(切磨抛+键合机)、晶盛机电(减薄机)。(4) 硅光设备: 罗博特科、奥特维(AOI 检测设备)。

【AI 设备】CSP 资本开支持续上修，看好北美算力链条硬件端持续受益

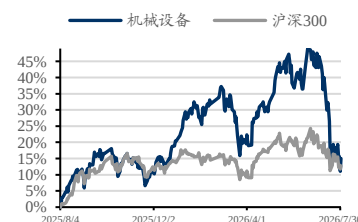
近期美国四大 CSP 均已发布最新财报，26 年 CAPEX 规划持续上修。①Amazon: 2026 年全年 CAPEX 指引 2200 亿美元，相比前期 2000 亿美元指引上调 200 亿美元; ②Microsoft: 2026 年全年 CAPEX 指引 1900 亿美元，相比前期指引维持不变; ③Google: 2026 年全年 CAPEX 指引 1950-2050 亿美元，相比前期 1800-1900 亿美元指引上调 150 亿美元; ④Meta: 2026 年全年 CAPEX 指引 1300-1450 亿美元，相比前期 1250-1450 亿美元指引上调下限 50 亿美元。四大 CSP 合计 2026 年 CAPEX 规划 7350-7600 亿美元。面向 2027 年，四大 CSP 均给出将持续提高 CAPEX 投入的指引，反映 AI 算力建设需求旺盛，硬件端有望持续受益。围绕海外算力建设加速，国产设备供应商有望受益。①PCB 设备: GB300 到 VR200 单机柜 PCB 价值量同比提升三倍以上，且英伟达/ASIC 链供应商有望持续扩容，众多 PCB 企业均积极导入海外链，同步规划大额扩产计划。近期鹏鼎、红板、深南、胜宏、沪电、广合、兴森等 PCB 板厂均推出一系列扩产计划，并且重点围绕 HDI 与 mSAP 工艺提出扩产计划，看好设备端持续受益。②液冷: 英伟达 VR200 逐步进入量产周期，谷歌 IronwoodV7 持续爬坡，液冷市场空间持续提升。单机柜算力密度的持续升级，风冷与风液混合逐步难以满足冷却要求，纯液冷方案成为标配。国产液冷供应商有望凭借成本优势与商务优势持续拓展海外算力链。投资建议: ①PCB 设备&耗材重点推荐【大族数控】【芯碁微装】【东威科技】【凯格精机】【鼎泰高科】【中钨高新】【新锐股份】【欧科亿】，建议关注【民爆光电】。②液冷重点推荐【英维克】【宏盛股份】【蓝思科技】【冰轮环境】，建议关注【领益制造】【申菱环境】【高澜股份】【鸿富瀚】【奕东电子】【中石科技】【同飞股份】【捷邦科技】【依米康】【飞龙股份】。

【工程机械】2026H1 出口金额同比+21.7%，建议关注板块低位布局机会

据海关数据，2026 年 6 月工程机械产品进出口总额达 67.1 亿美元，同比+24.6%，其中出口 64.7 亿美元，同比+25.5%; 2026H1 累计进出口 356.3 亿美元，同比+20.5%，其中出口 343.7 亿美元，同比+21.7%。板块国内市场由更新需求驱动，挖机及非挖设备销量保持较强韧性; 海外市场虽然部分区域增速可能因为基数提升而放缓，但非洲、拉美、东南亚等市场需求仍较旺盛，矿山机械也有望成为下一阶段的重要增长点。当前龙头公司估值已处于历史偏低水平，板块迎来低位配置窗口。重点推荐三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份、恒立液压，建议关注艾迪精密。

风险提示: 下游固定资产投资不及市场预期; 行业周期性波动风险; 地缘政治及汇率风险。

行业走势



相关研究

《半导体设备: SK 海力士业绩超市场预期，看好国内长鑫 HBM 扩产利好先进封测设备商》

2026-05-11

《PCB 设备 2025 年报&2026 年一季报总结: 业绩兑现元年，关注技术通胀带来的非线性增长》

2026-05-13

内容目录

1. 建议关注组合4

2. 近期报告4

3. 核心观点汇总4

4. 行业重点新闻16

5. 公司新闻公告17

6. 重点高频数据跟踪18

7. 风险提示20

图表目录

图 1: 2026 年 6 月制造业 PMI 为 50.3 %，环比增长 0.3pct..... 18

图 2: 2026 年 6 月制造业固定资产投资完成额累计同比-1.2%..... 18

图 3: 2026 年 6 月金切机床产量 9.0 万台，同比+18%..... 18

图 4: 2026 年 6 月新能源乘用车销量 100.7 万辆，同比-9%（单位：辆）..... 18

图 5: 2026 年 6 月挖机销量 2.5 万台,同比+35%（单位:台）..... 19

图 6: 2026 年 6 月国内挖机开工时长为 58.1 小时，同比-10%（单位：小时）..... 19

图 7: 2026 年 6 月动力电池装机 76.5GWh,同比+31%..... 19

图 8: 2026 年 5 月全球半导体销售额 1206.1 亿美元，同比+104%..... 19

图 9: 2026 年 6 月工业机器人产量 11.1 万套，同比+28%..... 19

图 10: 2026 年 6 月电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.5 万台,同比+9%..... 19

图 11: 2026 年 6 月全球集装箱船/油船/散货船新接订单量同比分别+53%/+291%/+21% 20

图 12: 2026 年 6 月我国船舶新承接/手持订单同比分别+238%/+41%..... 20

表 1: 建议关注组合..... 4

1. 建议关注组合

表1: 建议关注组合

所处领域	建议关注组合
光伏设备	晶盛机电、HJT 整线设备龙头、捷佳伟创、奥特维、双良节能、帝尔激光、高测股份、金博股份、罗博特科、金辰股份
半导体设备 & 零部件	北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、中科飞测、精测电子、长川科技、富创精密、芯源微、华峰测控、先导基电、新莱应材、华兴源创、英杰电气、汉钟精机、至纯科技、正帆科技、赛腾股份、神工股份
工程机械	三一重工、恒立液压、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、安徽合力、艾迪精密、柳工、山推股份、中国龙工
通用自动化	怡合达、埃斯顿、绿的谐波、海天精工、秦川机床、国茂股份、创世纪、伊之密、华中数控、科德数控、纽威数控、华锐精密、华辰装备、欧科亿、国盛智科、新锐股份
锂电设备	璞泰来、先导智能、杭可科技、赢合科技、东威科技、曼恩斯特、海目星、骄成超声、联赢激光、洪田股份、利元亨、先惠技术
油气设备	中海油服、杰瑞股份、海油工程、中密控股、纽威股份、石化机械、博迈科
激光设备	柏楚电子、锐科激光、杰普特、德龙激光
检测服务	华测检测、广电计量、谱尼测试、电科院、安车检测
轨交装备	中国中车、中铁工业、思维列控、康尼机电
仪器仪表	普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、优利德
船舶集运	中国船舶、中国动力、中集集团、中远海发

数据来源: Wind, 东吴证券研究所整理

2. 近期报告

【玻璃基板】深度报告: 材料变革与封装工艺升级共振, 产业化临界点将近

【杰瑞股份】点评报告: 百亿燃机复购订单持续超预期, AIDC 一体化打开成长空间

【纽威股份】点评报告: 新一轮股权激励落地, 绑定核心团队、彰显成长信心

【蓝思科技】点评报告: 蓝思科技携手 Intel 布局 TGV 先进封装, 打开半导体成长空间

3. 核心观点汇总

【玻璃基板】深度报告: 材料变革与封装工艺升级共振, 产业化临界点将近

AI 算力需求高增推高带宽需求, 玻璃基板有望开启先进封装的“材料革命”, 产业链设备与材料环节率先受益。后摩尔时代芯片制程红利趋缓, 先进封装成为提升系统性

能的关键路径；根据 Yole 数据，2024 年全球先进封装市场约 460 亿美元、同比+19%，2030 年有望达 794 亿美元、CAGR 约 9.5%。随着算力芯片与 HBM 高带宽存储协同要求不断提高，硅基与有机中介层/载板在大尺寸、翘曲控制、高频损耗等方面逐渐触及瓶颈，玻璃凭借机械尺寸稳定、CTE 可调、介电损耗低、表面平整、且可面板级大尺寸加工等本征特性，成为破局材料。当前时点产业共识正在形成：英特尔于 2026 年第 76 届 ECTC 发布玻璃芯基板量产技术突破，台积电推进面板级 CoPoS，康宁推出 Glass Bridge 玻璃桥 CPO 方案，京东方在 5 月 20 日公告与康宁合作、玻璃基封装载板试验线已通线并送客户认证，沃格光电、蓝思科技等亦密集布局，海内外龙头共同验证玻璃基板的产业化方向。

玻璃基板落地三大方案，层层递进打开设备与材料空间。1) 面板级封装 (CoPoS) 方案：玻璃作为方形临时载具，承载 CoWoS-L 式 RDL 重布线，在玻璃上打 TGV 玻璃通孔、金属化后制备 RDL，以 TGV 垂直互连；该方案相比圆晶圆更具经济性、支持面板级大尺寸，CTE 可调以改善翘曲，并可掏槽内嵌元件、演化出 5.5D 封装。2) 玻璃芯封装载板方案：以玻璃替代传统覆铜板有机核心层，机械刚性与介质损耗 Df 优于有机材料，更好满足高频高速传输。3) CPO 玻璃桥方案 (康宁)：在玻璃内部制作光波导，直接连接 PIC 与光纤、取代 FAU，显著降低耦合对位难度，并可与玻璃基板工艺相结合。三条主线的共同点是把价值量集中导向 TGV 打孔、金属化电镀、RDL 布线等前道图形化与镀铜环节。

核心增量在加工设备与材料：TGV 打孔（激光/刻蚀）、金属化与电镀、RDL 光刻是玻璃基板产业化的三大关键工艺环节。TGV 成孔以激光钻孔（紫外超快激光优于 CO₂）、激光诱导改性+湿法刻蚀、感光玻璃光刻为主流路线；金属化以磁控溅射种子层配合化学镀/电镀实现全铜填充；RDL 沿用硅基的电镀法与大马士革法，对直写光刻、垂直电镀与电镀化学药水提出更高要求。当前瓶颈集中在高深宽比成孔、电镀无空隙填充与玻璃开裂控制，正是国产设备与材料企业切入的窗口期。

投资建议：沿“激光—光刻—电镀”三条工艺主线，关注玻璃基板产业化中的国产设备与材料机会。（1）激光钻孔/改性设备：TGV 成孔是玻璃基板的关键工艺，相关标的为大族数控、帝尔激光、德龙激光；（2）光刻/直写设备：RDL 高密度布线与感光玻璃光刻环节，相关标的为芯碁微装；（3）电镀设备与电镀化学品：TGV 铜填充与 RDL 电镀是价值量核心环节，相关标的为东威科技、洪田股份、三孚新科。

风险提示：下游巨头玻璃基板导入进度不及预期；关键工艺良率突破不及预期；先进封装及 AI 算力需求不及预期。

【冰轮环境】深度报告：中国制冷工业奠基企业，AIDC 冷源赛道打开成长空间

中国制冷工业奠基企业，AIDC 新赛道打开成长空间。公司深耕制冷装备近 70 年，已形成低温冷冻+暖通空调+环保制热+能化装备多元化布局。子公司顿汉布什为公司切入海外 AIDC 高端冷水机组市场的核心平台，具备北美本土品牌认证、客户渠道及项目基础等稀缺优势。未来随着 AIDC 冷水机组需求持续释放，冰轮有望依托高端冷源产品+国内供应链协同，进一步强化业绩弹性。

工业制冷+中央空调双轮驱动，冷热主业基本盘稳健。（1）制冷：食品冷链端，受益于冷链仓储扩容、预制菜放量及政策支持，制冷压缩机组和速冻机需求保持稳健；能源化工端，行业需求由新增扩产转向存量技改，冰轮凭借多场景非标项目经验和系统集成交付能力，有望获取结构性增量订单。（2）暖通：国内中央空调市场维持千亿级体量，海外空间更为广阔，收购顿汉布什补强公司在高端冷水机组领域及渠道的布局。整体来看，公司传统冷热主业需求稳固，工业制冷规模优势、非标交付能力与体内高端冷源平台共同支撑业绩增长。

AIDC 冷源需求持续强化，顿汉布什体系具备高度稀缺性。Rubin 架构虽提高了进液温度，但并不改变冷水机组配置逻辑。在散热需求总量提升、冗余配置要求及区域高温气候约束下，AIDC 一次侧冷机需求仍会持续释放。同时，PUE/TCO 要求推动冷机从传统螺杆式向更高价值量的磁悬浮离心式升级，构筑产品结构通胀弹性。顿汉布什作为北美本土冷水机组品牌，可大幅降低冰轮出海的合规认证与渠道建设成本，叠加公司国内供应链与马来西亚产能支撑，有望承接 AIDC 订单外溢，助力公司中长期业绩上行。

盈利预测与投资建议：公司作为国内制冷龙头，食品冷链、能源化工、中央空调基本盘稳健，通过核心压缩机自主配套+非标系统集成+海外本地化交付能力构筑显著竞争壁垒，有望持续受益 AIDC 驱动的冷源需求上行趋势。我们预计公司 2026-2028 年归母净利润为 8.3/12.2/17.0 亿元，当前市值（截至 2026/7/2）对应 PE 分别为 63/43/31X，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：下游需求波动风险、AIDC 订单不及预期、海外经营及交付风险等

【存储测试机】专题：AI 算力催生 HBM 带动测试机新需求，国产设备商加速突破

存储持续涨价&两存上市在即，看好存储未来扩产持续性。自 2024 年底以来，在 AI 算力需求拉动下，DRAM 与 NAND Flash 现货价格均进入快速上行通道，DDR4（8Gb）2024 年底到 2026 年 6 月涨幅超 17 倍，DDR5（16Gb）2025 年 11 月至 2026 年 6 月底涨幅约 4.9 倍。长鑫存储 2025 年营收 618 亿元，2026Q1 营收同比+719%，产能利用率 2024Q1 以来长期维持 90%以上，资本开支持续高位。中国头部存储厂商与国际龙头产能差距显著，后续扩产空间广阔。

AI 算力催生 HBM 需求，HBM 成为 AI 芯片主流方案。AI 服务器出货量 2023-

2025 年接近翻倍，Trendforce 预计 2026 年达 275 万台。HBM 凭借高带宽、低延迟、低功耗优势成为应对内存墙的核心技术，在 AI 服务器 BOM 中价值量占比快速提升。2025 年 HBM 市场基本由 SK 海力士（占据市场份额 58.3%）、三星和美光占据，海外龙头已陆续实现 HBM4 量产，国内长鑫存储预计 2027 年实现 HBM3e 量产。

HBM 堆叠对测试机提出 KGSD 等新需求，存储测试机需求量价齐升。HBM 采用 3D 堆叠架构，测试重心前移至 KGSD 测试环节，测试道数由传统 DRAM 的 3-4 道提升至 15 道以上，存储测试机需求约为传统 DRAM 的 5-6 倍。HBM 对测试设备在供电能力、时序精度、高并行测试能力及测试算法等方面均提出更高要求。

存储测试机国产化率极低，国产替代空间广阔。存储测试机市场 2025 年由爱德万（占据市场份额 61%）和泰瑞达（占据市场份额 24%）主导，国内国产化率仅 8-10%，显著低于其他测试设备细分赛道，是半导体设备自主可控的重要短板。地缘政治环境复杂化背景下，国产替代逻辑强化，国内厂商正加速布局。

投资建议：重点推荐国内存储测试机领先布局厂商，重点推荐【长川科技】、建议关注【精智达】、【联讯仪器】、【悦芯科技（未上市）】。

风险提示：封测设备需求不及预期、技术研发不及预期、行业竞争加剧。

【光模块】测试仪器专题：光模块量产“卖铲人”，受益行业通胀、供需缺口与国产替代

光模块等 AI 基础设施需求爆发，配套测试仪器量价齐升：2025 年全球算力需求爆发，算力竞争持续升级，其中光模块作为 AI 核心基础设施，技术升级和扩产提速。光模块研发、量产环节均需检测，尤其量产环节客户基本要求全检，随光模块速率升级（800G→1.6T→3.2T）、形态演进（可插拔→CPO），配套的测试设备精度提升、测试时间拉长，价值量和需求量将翻倍。其中，采样示波器为光模块测试核心仪器，根据我们测算其 2027 年市场规模预计突破 200 亿元。过去光模块测试仪器由海外龙头是德科技、安立等垄断，国产化率不足 20%。由于科学仪器赛道特殊性，本身扩产困难，外资龙头难以满足增量需求，供需缺口和国产替代趋势下，已有技术和渠道储备的国产龙头迎来发展机遇。

芯片为测试仪器卡脖子环节，供需缺口、政策催化加速国产替代：芯片为电子测量仪器核心零部件，承担着信号转换、调制解调、数字处理与编码解码等关键功能，其发展水平决定了测试仪器设备的功能实现及性能边界。由于测试仪器细分赛道多而单赛道天花板低、高端仪器的核心芯片专业性强、性能要求高、研发成本高昂，市面上通常不存在成熟的商用芯片，倒逼厂商自研。以采样示波器为例，10GHz 和 30GHz 阶段，仪器厂通过采购成熟芯片、优化硬件板卡和算法软件，即可满足性能需求，而在 50GHz 及以上阶段，商用放大器芯片已无法支持采样示波器性能要求。1.6T 光模块的信号基频达

到了 56GHz，1.6T 时代仅有自研芯片能力的厂商才可入局。

看好与国产链深度绑定、已有技术布局的国产测试仪器龙头:推荐普源精电：国内唯一搭载自研 ASIC 数字示波器商业化落地的企业。建议关注（1）联讯仪器：全球第二家推出业内最高水平 1.6T 光模块全部核心测试仪器的厂商；（2）华兴源创：收购普赛斯布局示波器、源表和误码仪；（3）华盛昌：收购伽蓝特布局光源、光功率计、误码测试仪和光时钟恢复仪；（4）鼎阳科技：国内头部电子测量仪器供应商，可为光模块、AI 芯片等下游客户提供测试仪器；（5）优利德：国内头部测试测量仪器供应商，收购信测通信布局通信光功率计、光时域反射仪、光纤传感和电磁测量。

风险提示：新品推出不及预期、国际贸易摩擦风险、市场竞争加剧。

【PCB】设备专题报告：mSAP 工艺应用场景拓展，设备股迎成长新机遇

AI 硬件升级驱动 PCB 性能要求提升，mSAP 工艺应用边界持续拓宽，迎来扩产放量。伴随 1.6T 光模块、CoWoP 工艺及 NPO 的加速渗透，mSAP 工艺正快速向光模块、先进封装等场景拓展。1.6T 光模块量产落地促使 PCB 线路精度要求提升至 15 μ m 级别，布线密度大幅提升。传统 Tenting 工艺难以满足高密度互联需求，mSAP 工艺通过超薄种子铜层、图形电镀、闪蚀等流程，可实现陡直线路侧壁与高精度线宽控制，能够适配高密度布线与低信号损耗需求，成为高阶 PCB 的主流升级方案。长期来看，CoWoP、NPO 等下一代封装与光学技术演进，将进一步推进 PCB 载板化需求，持续打开 mSAP 工艺的市场空间。下游 PCB 厂商加速 mSAP 产能布局，鹏鼎、深南、兴森、景旺、红板、方正等头部厂商均投资规划新增多条 mSAP 产线，直接拉动高阶设备需求增长。

mSAP 工艺驱动设备技术升级，钻孔/电镀/LDI/成型四大核心环节受益。mSAP 工艺突破了传统减成法的精细线路局限，对多环节核心设备提出更高阶的技术要求，微孔加工精度、曝光对位精度、电镀铜厚均匀性等技术门槛大幅抬升：①钻孔环节：孔径缩小至 50 μ m 左右，超快激光钻孔机具备更强的小孔加工能力，成为解决 CO₂ 激光钻局限的更优解决方案；②电镀环节：要求铜厚均匀性偏差控制在 $\pm 5\%$ 以内，垂直连续电镀（VCP）设备、水平三合一设备价值量大幅攀升；③曝光环节：线宽线距缩小至 15 μ m，倒逼激光直接成像（LDI）设备成像精度与对位精度要求提升；④成型环节：针对 1.6T 光模块等小面积复杂结构，CCD 锣机等高精度成型设备成为刚需。技术升级带动设备单价与壁垒同步提升。

国产厂商突破技术壁垒，国产替代与批量交付正加速兑现。国内厂商已实现多环节技术突破，逐步进入头部客户供应链。①大族数控：覆盖钻孔、曝光、成型全流程，超快激光钻孔机已在头部客户实现批量化生产，CCD 锣机成为 1.6T 光模块成型的优质方案；②东威科技：mSAP 移栽式 VCP 及水平镀三合一设备量产领先，打破国外垄断。

国产设备凭借产品性能、交付周期与本地化服务优势加速替代；③芯碁微装：作为 PCB

直写光刻龙头，MAS6P 系列 LDI 设备解析能力达 6/6μm，生产效率领先国际同类产品；

④洪田股份：通过收购东莞速远、控股洪镭光学，布局高端电镀与光刻环节，解决 mSAP 高孔径比多层板填孔工艺，可满足 HDI 及 IC 封装基板的 mSAP 工艺需求。

投资建议：推荐【大族数控】【东威科技】【芯碁微装】【洪田股份】。

风险提示：宏观经济波动风险，PCB 工艺进展不及预期风险，算力服务器需求不及预期风险。

【蓝思科技】深度报告：大客户创新大年开启价值量拐点，新兴赛道多点布局打开长期成长空间

深耕 AI 端侧应用 20 年，大客户创新大年与新兴赛道共振：公司以消费电子精密制造起家，历经 20 余年深耕构筑平台型制造能力，形成从防护玻璃、金属结构件到整机组装的全链条垂直整合布局。苹果折叠屏 iPhone 有望于 2026 年正式推出，作为苹果消费电子核心供应商，公司将充分受益于新品带来的单机价值量提升。同时，公司持续向人形机器人、AI 眼镜、AI 服务器液冷、商业航天等新兴领域延伸，多赛道协同打开中长期成长空间。

智能手机与电脑业务为核心基本盘，AI 端侧景气改善带来业绩修复：智能手机与电脑类业务 2025 年实现收入 611.8 亿元，占总营收比重达 82%，是公司最核心的收入来源。公司深度绑定苹果供应链，产品覆盖防护玻璃、金属中框、触控模组、蓝宝石镜片等核心零部件。彭博社预计苹果折叠屏于 2026 年正式推出，折叠屏设备对精密玻璃、铰链结构件、触控模组的要求均大幅高于传统直板机，单机价值量有望较传统机型实现可观提升。公司已具备航天级 UTG 材料量产能力，并在 3D 曲面玻璃、超薄盖板玻璃领域持续深耕，技术壁垒深厚，有望充分分享折叠屏放量带来的价值量增长红利。

深度绑定特斯拉供应链，人形机器人批量交付打开第二成长曲线：AI 智能化驱动背景下，人形机器人作为最佳硬件载体，未来成长空间广阔。公司把握人形机器人产业发展机遇，积极拓展机器人领域版图，国内方面深度绑定智元，并与优必选，灵心巧手，越疆机器人等企业合作开发机器人产品。海外方面公司已进入特斯拉 Optimus 供应链体系，在灵巧手、行星滚柱丝杠、六维力矩传感器等关键模组上实现量产能力储备。

拟并购元拾打通 AI 服务器液冷产业链，有望深度受益算力基建扩张：为满足 AI 算力需求，服务器性能跃升直接导致芯片功耗与机柜功率密度急剧攀升，液冷成为服务器标准解决方案。2026 年公司拟收购元拾科技，从而获取英伟达机架产品、液冷模组的 RVL/AVL 认证，形成完整的二次侧散热解决方案，精准切入英伟达下一代 Rubin GPU 集成化需求。

UTG 材料前瞻布局，覆盖商业航天全链条：公司航天级 UTG 超薄柔性玻璃是柔性

太阳翼封装的核心材料，同步布局太空轻量化机柜、TGV 玻璃基板等产品，平台型制造能力赋予公司持续切入高附加值新赛道的能力。

盈利预测与投资评级：考虑到折叠屏 iPhone 量产带动公司单机价值量提升及新兴赛道快速放量，2026E-2028E 归母净利润分别为 43.3/65.7/82.0 亿元，当前股价（截至 2026 年 6 月 22 日）对应动态 PE 分别为 68/45/36x，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：宏观经济波动风险；折叠屏渗透不及预期风险；客户集中风险。

【长川科技】深度报告：国产 SoC 测试机龙头，看好公司份额持续提升&存储测试机第二曲线

AI 算力芯片放量，SoC 测试机进入量价齐升周期。AI/HPC 芯片向先进制程、Chiplet 及先进封装持续演进，测试步骤和测试时长显著增加。全球 SoC 测试机市场规模预计由 2023 年的 33 亿美元增长至 2026 年的 91 亿美元，2023-2026E CAGR 达 40%。

国产算力崛起带动国内 SoC 测试需求快速提升。当前海外 SoC 测试需求已以 AI 芯片为主，而国内仍以手机芯片为主。随着华为昇腾、寒武纪、海光等国产算力芯片持续放量，中国 AI 芯片测试需求占比有望快速提升，带动国产测试设备需求增长。

自主可控趋势强化，测试机国产替代空间广阔。全球测试机市场长期由爱德万和泰瑞达主导，其中爱德万市占率达 65%（销售额口径）。美国持续升级半导体限制叠加中日关系变化，自主可控重要性进一步提升。按 2025 年市场测算，仅测试机领域国产替代空间即超过百亿元。

先进封装扩产带来测试设备增量需求。盛合晶微、长电科技、通富微电、华天科技等头部封测厂持续扩张先进封装产能。测试机通常为封测厂资本开支占比最高设备之一，先进封装扩产将持续拉动测试设备需求增长。

HBM 推动存储测试机进入新周期。HBM 采用多层 DRAM 堆叠及 TSV 结构，新增 KGSD、TSV、CoW 等测试环节，测试复杂度显著提升。随着 AI 训练卡对 HBM 需求快速增长，存储测试机迎来需求扩张与技术升级双重驱动。

投资建议：我们基本维持公司 2026-2028 年归母净利润分别为 21.5/30.4/41.5（原值 22.8/31.2/42.3）亿元，2026-2028 年当前股价（截至 2026/6/15）对应动态 PE 分别为 66/47/34 倍；公司的 SoC 测试设备和存储测试设备技术国内领先，未来将受益于半导体测试领域国产化进程的不断推进，综合来看成长性较为突出，维持“买入”评级。

风险提示：封测设备需求不及预期，技术研发不及预期，行业竞争加剧。

【锡膏行业】深度报告：AI 时代工业血液，光模块新增需求带动“量价齐升”

锡膏系电子联装环节核心耗材：电子锡焊料主要用于电子联装环节，是 PCB 裸板生产完成后，将电子元器件（电阻、电容、芯片等）等零散零部件互联的制造过程，电子锡焊料下游应用领域广泛，主要包括消费电子、通信和计算机等。根据 QY Research 报告，2023 年中国电子级锡焊料市场规模为 42.08 亿美元。锡膏系电子锡焊料的细分品类，主要用于微电子精密焊接，下游包括半导体封装、mini-led 等。锡膏由锡合金粉与助焊膏搅拌混合而成。随着先进封装的发展，元器件逐步缩小，所需锡膏的粉末颗粒也越小，锡膏正逐步向精细化、绿色化和低温化发展。

光模块高端化升级，带动锡膏“量价齐升”：光模块生产过程中存在多类焊接及电气互联环节，主要包括 PCBA 贴装焊点、光器件内部精密焊点以及外壳结构封装固定。光模块升级对锡膏的拉动可以拆为“量”和“价”两条主线。1) 量提升：一是 AI 算力需求推动高速光模块出货增长；二是速率提升带来通道数、DSP 基座、光芯片、电芯片、无源器件及连接器数量增加，单模块锡点数量和用膏量同步提升；2) 价提升：焊点尺寸和间距持续微缩，封装形态从板级组装向 2.5D/3D 高密度互联演进，推动锡膏等级由 T5/T6 向 T7/T8 升级，同时对低残留、热稳定、抗蠕变和低信号衰减提出更高要求，锡膏价格快速提升。

竞争格局：外资为主，国产加速替代。半导体封装高端锡膏主要外资主导。全球半导体封装焊膏市场呈现高度集中态势，以海外龙头为主，主要包括美国爱法、美国钨泰、日本千住和德国贺利氏。国内来看，高端超细锡膏产能极度稀缺，以唯特偶主导，未来随着光模块对高端锡膏产能需求爆发，海外产能供不应求，国产锡膏有望加速国产替代。

相关公司：光模块速率升级，PCBA 焊点数量提升，带动锡膏用量提升。同时锡膏向精细化发展，粉径缩小，价值量提升；此外锡膏难度大，过去多用于半导体，且以海外为主，竞争格局良好，需求爆发下国产公司加速海外替代。建议关注锡膏行业龙头【唯特偶】【华光新材】，锡粉供应商龙头【有研粉材】。

风险提示：宏观经济变化及下游行业波动的风险，市场竞争加剧风险，原材料价格波动风险。

【PCB 设备材料】行业深度报告：材料端供需缺口愈演愈烈，扩产带来国产设备铲子股机遇

AI 拉动 PCB 扩产，上游原材料缺口紧张。25 年起，PCB 行业产能日益趋紧，主流厂商加速扩产，资本开支端反应明显，2025 年 9 家头部 PCB 企业资本开支达 267 亿元，同比+111%，2026Q1 资本开支达 125 亿元，同比增速达到 182%，仍在加速。现阶段扩产仍主要以胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股为主，我们判断后续深南电路、景旺电子、方正科技、广合科技等有望接棒加速。在 PCB 中，铜箔、电子布和树脂三种材料共同构

成了 PCB 物理基础。①铜箔：铜箔是 PCB 上的导电层，是负责导电的“公路网”。它的核心作用是经过 LDI 和刻蚀后留下的线路可以传输电信号。②电子布：电子布由极细的玻璃纤维编织而成，主要为电路板提供机械强度和刚性，是提供强度的“钢筋”，防止 PCB 出现弯曲与形变。③树脂：PCB 中通常使用的是环氧树脂，是负责粘合的“水泥”，一方面结合电子布、铜箔；另一方面绝缘防止发生短路。

原材料价格飞涨，国内厂商加速扩产实现替代。建滔积层板 2025 年以来经历了 7 次涨价，主要因上游原材料需求紧张涨价拉动。HVLP 铜箔与高端电子布过往供应商主要为日韩企业。HVLP 铜箔的主力供应商包括日本三井、日本古河、日本福田、韩国斗山，电子布的主力供应商包括日本日东纺、日本旭化成。算力建设的非线性增长带动 PCB 材料需求快速提升，而日韩企业扩产意愿弱速度慢，供需缺口持续拉大。目前进口铜箔设备与电子布设备均处于供不应求状态，看好国内企业扩产带动设备国产机遇。目前核心设备如日本新日铁与三船的铜箔表面处理机，以及丰田、津田驹电子布织布机均处于供不应求状态，看好国产设备厂商在本轮扩产机遇下实现国产替代。1 铜箔设备重点增量为表面处理机。①溶铜罐：将高纯度电解铜溶解并制备成符合要求的硫酸铜电解液；②阴极辊：通过电解反应将铜离子在阴极辊表面沉积为原箔，对表面光洁度要求较高；③生箔机：为电解阳极，在高速旋转的阴极辊表面连续析出铜箔；④表面处理机：在保持极低粗糙度的前提下通过电镀工艺在铜面上均匀生长出极细微的颗粒。表面处理环节是国内外铜箔企业技术差距最大的领域，也是制约国内 HVLP 铜箔产能扩张的主要瓶颈。

电子布设备重点卡脖子环节为喷气织布机。①池窑拉丝线：铂铑合金漏板与高速拉丝机搭配使用，生产玻纤丝线；②捻丝机：单丝直径太细，需要经捻丝机并合捻丝，成为可用于织布的电子纱；③喷气织布机：利用压缩空气作为引纬介质，通过气流牵引纬纱穿越梭口，实现高速、高精度织造，可实现电子布对微米级厚度精度和零瑕疵的苛刻要求。织布机非常依赖进口品牌。丰田 JAT910 系列织机是唯一能稳定量产 1080 及以下超薄电子布的设备，目前泰坦股份与卓郎智能正在验证，有望实现国产替代。

投资建议：铜箔设备建议关注【洪田股份】【泰金新能】；电子布设备建议关注【泰坦股份】【卓郎智能】。

风险提示：宏观经济波动风险，PCB 工艺进展不及预期风险，算力服务器需求不及预期风险。

【中国动力】深度报告：船用发动机龙头，后市场+AIDC 业务打开成长空间

中国动力：中船旗下核心动力装备上市平台，利润迎向上拐点：中国动力为中船集团旗下核心动力装备上市公司，已形成覆盖柴油动力、化学动力、燃气蒸汽动力等七类动力业务及机电配套业务，产品包括柴油机、蓄电池、燃气轮机、电机、齿轮箱等，下

游覆盖国防动力、船舶海工和其他（工业、汽车、风光储等）。公司在国内船舶动力系统研发设计、集成制造、设备配套、保障服务等领域稳居龙头地位。2022 年以来，受益于新造船市场复苏、船用柴油机需求增长，量价利齐升，柴油动力成为公司第一大业务板块，2025 上半年营收占比约 50.5%、毛利占比约 70%，公司盈利同样迎来向上拐点，2025 年前三季度实现归母净利润 12.1 亿元，同比增长 62%。中国动力的柴油机业务主要由控股子公司中船柴油机开展，持股比例约 52%。2025 年 4 月公司发布公告，拟发行可转债收购中船工业持有的中船柴油机 16.5% 股权，进一步加强对柴油机业务的控制力，且若成功收购，归母净利润有望增厚 10 亿元以上。尽管 2025 年 10 月公司公告收购中止，我们判断中国动力已定位为中船集团旗下动力总成平台，资源整合注入为确定趋势，该少数股权收购方案优化、重启可期。

新造船市场景气度延续，发动机量价利齐升：船舶行业供需缺口短中期难以消解，造船行业景气度有望持续，发动机为船舶核心零部件，需求可持续。且受益于航运业绿色转型，产品向双燃料升级，价值量显著提升。中国动力产品覆盖高、中、低速船用柴油机及柴油发电机组：在低速柴油机领域，公司具备 MAN、WinGD 全系列制造调试服务能力，覆盖全部主流船型；双燃料领域，公司具备 LNG/LPG/甲醇/乙烷/氨等双燃料低速机生产能力。展望后续，我们看好中国动力船用柴油机业务成长前景：1）低速机份额稳固，环保+技术升级下量价利齐升：公司作为中船下柴油动力核心平台，渠道优势、品牌优势和规模效应明显，市场地位稳固。公司船用低速机根据船厂订单排产，当前头部船厂新船交付排至 2030 年，且随环保约束增强、双燃料等技术升级，发动机量价利将齐升。2025 上半年公司新签订单 339 亿元，同比增长 25%，在手订单 628 亿元，创历史新高，同比增长 8%，较年初增长 7%。2）后市场服务打开成长空间：公司已初步建立低速机全球服务网络，覆盖亚太、欧洲、美洲等主要航运港口，初步满足 WinGD 主机全球服务需求。后市场服务具备周期性弱、盈利水平高的特点，有望成为公司船用柴油机板块的第二成长曲线。

AIDC 缺电带动“船改燃”技术渗透，有望打造新增长曲线 AI 电力需求。综合考虑成本、建设周期、环保等因素，燃气轮机是当前 AIDC 自建电最优解，但当前时点，全球燃机产能明显不足，GEV、西门子、三菱重工等燃机龙头订单交付已经排至 2029 年。在此背景下，“船改燃”——将柴油发动机改造为燃气发电设备成为补充方案。中国动力有望受益 AIDC 缺电下，燃气轮机、燃气内燃机、柴发设备需求增长，打造新增长曲线：①公司具备 3-50MW 小型燃气轮机供应能力，现有应用领域包括天然气长输管线增压、陆上/海上油气平台、工业园区分布式能源等，技术可切换至 AIDC。②公司于中速机与双燃料技术储备深厚，具备船用动力与电站动力双场景适配能力，在船改燃领域具备天然资源与技术优势。③公司的柴油发电机组业务已针对 AIDC 需求研制样机，进入市场拓展阶段，且陕柴在核电站应急柴发电机组领域经验成熟，可迁移至数据中心备用电源场景。

盈利预测与投资评级：我们预计公司 2025-2027 年归母净利润为 22/31/41 亿元，当

前市值（截至 2026/3/30）对应 PE 分别为 33/23/18 倍。公司为全球船用发动机龙头，受益于造船周期上行，燃机出海与后市场业务有望贡献显著业绩弹性，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：国际贸易政策变化风险、原材料价格波动风险、汇率波动风险

【半导体设备】2026 年行业策略：看好存储&先进逻辑扩产，设备商国产化迎新机遇

AI 驱动先进逻辑与存储扩产，资本开支进入新一轮上行周期。在 AI 算力需求爆发背景下，全球半导体设备市场规模持续创新高。先进逻辑端，FinFET 向 GAA/CFET 演进，5nm 及以下制程单位产能设备投资额显著提升，单万片/月产能投资额较 28nm 提升数倍；存储端，HBM 带动 DRAM 高阶制程升级，3DNAND 向 400 层以上堆叠演进，单万片产能投资额同步提升。中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比，逻辑与存储龙头资本开支维持高位，叠加两大存储厂商上市融资在即，扩产动能具备持续性，支撑前道设备景气度中长期上行。制程迭代推动设备结构升级，刻蚀与薄膜沉积价值量提升。先进制程结构复杂化带动图形化环节投资强度提升。逻辑端 GAA 结构、存储端高层数 3D 堆叠，对高深宽比刻蚀（HAR）、高选择比刻蚀（ALE）以及 ALD 等原子级沉积技术提出更高要求。刻蚀与薄膜沉积在前道设备中的价值占比位居前三，且随制程演进呈提升趋势。多重曝光、先进金属材料替代及新型结构引入，使设备数量与工艺复杂度同步提升，设备投资呈现“技术节点越先进、单位投资越高”的乘数效应，核心平台型设备商与细分龙头有望持续受益。

外部制裁强化自主可控逻辑，国产替代进入加速阶段。美国、荷兰、日本持续强化对 14nm 及以下先进制程设备出口限制，中国大陆作为全球最大设备需求市场，进口依赖度较高的涂胶显影、清洗、量检测、光刻等环节国产化率仍低于 25%。在政策支持与大基金三期落地背景下，国内晶圆厂扩产将更加倾向国产设备采购。测算显示半导体设备整体国产化率已由 2017 年的 13% 提升至 2024 年的 20%，预计 2025 年达 22%，仍具备广阔提升空间。平台型厂商覆盖面扩大、技术持续突破，将在先进制程与先进封装领域获得更大份额。

投资建议：重点推荐前道平台化设备商【北方华创】【中微公司】，低国产化率环节设备商【芯源微】【中科飞测】【精测电子】，薄膜沉积设备商【拓荆科技】【微导纳米】，后道封装测试设备【华峰测控】【长川科技】【迈为股份】；零部件环节【新莱应材】【富创精密】【晶盛机电】【英杰电气】【汉钟精机】。

风险提示：半导体行业投资不及预期，设备国产化进程不及预期，技术迭代及工艺路线变化风险。

【北方华创】深度报告：平台化半导体设备龙头，受益于下游资本开支扩张&国产化率提升

看好先进逻辑&存储加速扩产：晶圆厂扩产方面，我们预计 2026-2027 年内资晶圆厂资本开支持续扩张。1) 逻辑端：中芯国际自 2023 年起产能利用率稳步提升，2025Q3 已升至 95.8%；国内厂商先进逻辑工艺陆续突破，有望加速落地先进制程产能。2) 存储端：2024 年全球 NAND/DRAM 存储器市场中，我国长江存储&长鑫存储市占率分别仅为 5/5%（销售额口径），后续仍待突破，我们预计 2026 年长江存储与长鑫存储合计新增 10-12 万片/月产能，重点聚焦于 3DNAND 与 HBM 制程，投资总额有望达 155-180 亿美元。根据 SEMI 预测数据，2026-2027 年全球晶圆厂设备支出约 8827/9471 亿元，分别同比增长 9/7%。叠加自主可控需求，我们预计 2026-2027 年中国大陆晶圆厂设备销售额将达 4414/4736 亿元，分别同比+21/7%。

海外限制不断收紧，半导体设备国产替代诉求迫切：美日荷持续强化对先进制程设备出口限制，国内晶圆厂在自主可控导向下加快国产设备导入进程。2024 年中国大陆半导体设备销售额达 495 亿元，全球占比 42%，连续四年为全球第一大设备市场。我们预计 2025 年半导体设备国产化率提升至 22%，其中刻蚀、清洗、CMP 等环节已实现阶段性突破，光刻、薄膜沉积、检测、涂胶显影等高端环节国产化率仍低于 25%，替代空间广阔。

内生+外延不断拓展公司产品线，彰显半导体设备龙头地位：作为国产半导体设备领军者，公司持续受益设备国产替代+产品线延展。1) 刻蚀设备：我们预估 2027 年中国大陆半导体干法刻蚀设备市场规模达到 895 亿元。公司在 ICP 领域主导国内市场，同时积极布局 CCP 领域，市占率持续提升，高深宽比刻蚀取得率先突破。2) 薄膜沉积设备：我们预估 2027 年中国大陆半导体薄膜沉积设备市场规模将达 1089 亿元。公司 PVD 市场竞争力显著，持续拓展 CVD、ALD 等产品系列，已跻身国内第一梯队，不断打开成长空间。3) Track 设备：我国涂胶显影市场规模 2025 年有望达 143.7 亿元、2025 台。芯源微是国内首具备量产交付能力的企业，公司通过获得芯源微股权填补 Track 产品空白，有望充分受益于 Track 国产替代进程。4) 热处理设备：我们预计 2027 年中国大陆热处理设备市场规模约为 210 亿元，公司已具备较强市场竞争力，25H1 该业务收入 10 亿元。5) 清洗设备：我们预计 2027 年中国大陆市场规模约 243 亿元，公司收购 Aktron 完善清洗设备产品线，产品体系不断完善，已成功覆盖槽式、单片清洗设备。6) 其他：公司积极拓展离子注入机、电镀设备等品类，平台化布局持续深入。

盈利预测与投资评级：考虑到公司 2025-2027 年集中进行研发投入，我们下调 2025-2027 年归母净利润为 58.50（原值 65.1）/77.84（原值 88.0）/102.39（原值 110.9）亿元，分别同比+4%/+33%/+32%。当前股价（截至 2026/1/23）对应动态 PE 分别为 63/48/36 倍，考虑到公司平台化布局持续推进，维持“买入”评级。

风险提示：半导体行业投资不及预期、设备国产化不及预期、海外限制加剧风险

4. 行业重点新闻

AIDC 基建：AWS、Meta 推行“模块化”数据中心，建设周期压缩 36%、降本 8%

研究机构 SemiAnalysis 在最新深度报告中指出，从超大规模云厂商到 AI 实验室，模块化已成为快速建设数据中心的默认方案——建设周期可压缩约 36%（相当于缩短 7 至 9 个月），综合资本开支每兆瓦可降低约 8%。

AWS 正在大规模推进代号“SAMDC”的模块化设计，其内部项目“Project Houdini”将白空间建设拆解为可在工厂预制的标准化机架，把服务器入驻前的准备时间从最长 15 周压缩至 2 至 3 周，并可消减单个模块超过 5 万工时的现场电气安装工作量。

Meta 则在俄亥俄州 New Albany 的 Prometheus 园区部署铝框架织物结构“帐篷”厂房，卫星图像显示，自 2025 年 7 月宣布建设至 2026 年 4 月，已有 8 座结构竣工——而园区此前五栋永久建筑耗时长达两至三年。

SemiAnalysis 的模块化追踪器已覆盖超过 61GW 的模块化容量及逾 1000 个采用某种预制策略的站点，**预计到 2028 年底，模块化建设占全部在线容量的比例将突破 30%**。对于云服务商而言，速度直接等于营收，每提前一个月交付每兆瓦 IT 算力，保守估计可为业主运营商带来约 50 万美元的价值捕获，**按 50MW 机房测算，相对纯现场建设可带来约 2 亿美元的未折现收益。**

来源：华尔街见闻

叉车：中力股份与德国永恒力达成中长期战略合作

近日，德国永恒力集团（Jungheinrich AG）完成对中力股份 4.9% 的股权收购。顺应全球内部物流电动化、低碳化、智能化发展趋势，中力股份与德国永恒力（Jungheinrich）正式达成中长期战略投资及业务协同合作。双方将依托联合打造的全新独立品牌 AntOn by Jungheinrich，向全球市场推出全新锂电仓储叉车设备，携手拓展全球物料搬运市场空间。

作为电动仓储叉车、数智移动设备领域的持续创新企业，中力股份拥有成熟的规模化制造能力、完整锂电产品体系以及全球化渠道基础。永恒力则拥有七十余年工业车辆深厚积淀，是全球内部物流解决方案头部企业。

本次战略合作实现资本与业务双向赋能，双方将充分发挥各自优势，共同开展**产品开发、市场推广**等协同工作，打造**适配全球广泛客户的物料搬运解决方案**。

持续推进全球化布局是中力股份长期核心战略。此次永恒力战略入股，是公司**链接**

全球产业资源、拓宽海外健康可持续发展市场空间的重要举措。

来源：中力股份公众号

5. 公司新闻公告

纽威股份（603699.SH）：拟推 2026 年限制性股票激励计划

2026 年 7 月 28 日，纽威股份公布 2026 年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 499.4259 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.64%。

公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 1%。

杰瑞股份（002353.SZ）：关于公司董事长、副总裁增持股份计划的实施进展公告

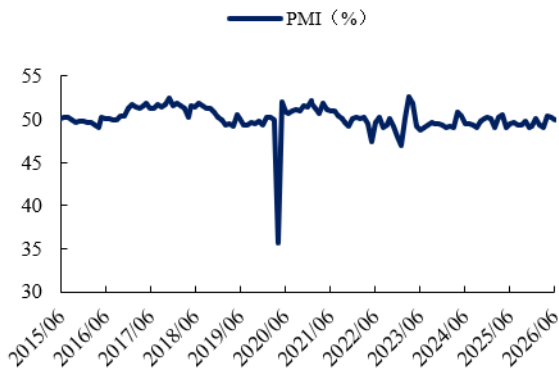
2026 年 7 月 28 日，杰瑞股份发布公告称公司董事长李志勇、副总裁李慧涛、路伟三人计划自 2026 年 5 月 27 日起 6 个月内，以自筹资金累计增持公司股票不低于 800 万元、不超过 1,000 万元。增持前，三人合计直接持有公司股票 1,080,449 股，占总股本 0.106%；其中李志勇持股 711,549 股（0.069%），李慧涛 173,900 股（0.017%），路伟 195,000 股（0.019%）。三人此前于 2024 年 9 月至 2025 年 3 月完成过一次增持，累计购入 203,600 股，金额 716.83 万元，期间及本公告前 6 个月内均无减持行为。

截至 2026 年 7 月 28 日，三人已完成第一阶段增持，累计买入 66,900 股，成交金额 930.93 万元（不含交易费用），均价 139.15 元/股，已达成原计划金额区间下限并接近上限。增持后，三人合计持股增至 1,147,349 股，占总股本 0.112%。其中，李志勇增持 22,100 股（金额 306.40 万元），李慧涛增持 22,500 股（313.23 万元），路伟增持 22,300 股（311.29 万元），三人增持比例均约 0.002%-0.003%，持股比例小幅提升。

来源：Wind

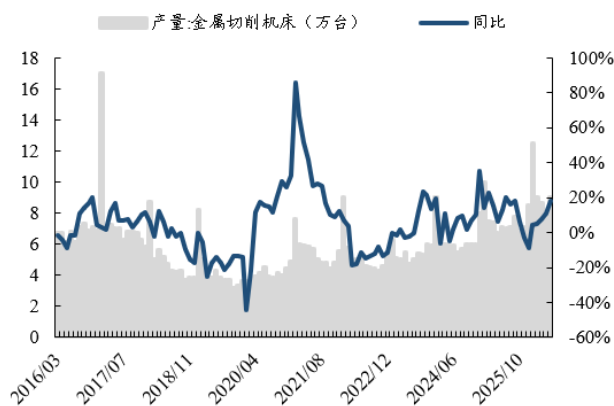
6. 重点高频数据跟踪

图1: 2026 年 6 月制造业 PMI 为 50.3%，环比增长 0.3pct



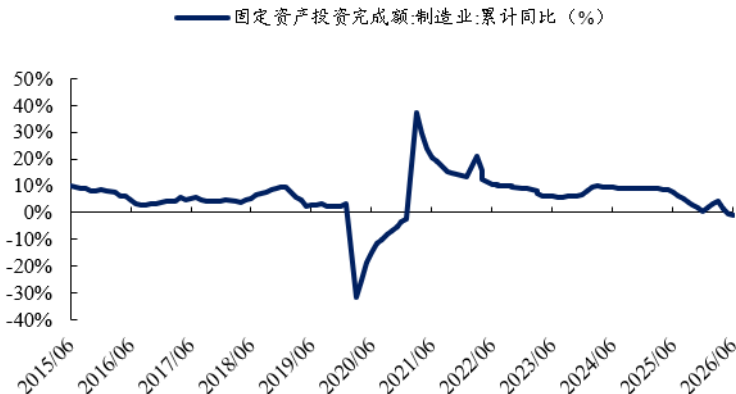
数据来源：国家统计局，东吴证券研究所

图3: 2026 年 6 月金切机床产量 9.0 万台，同比+18%



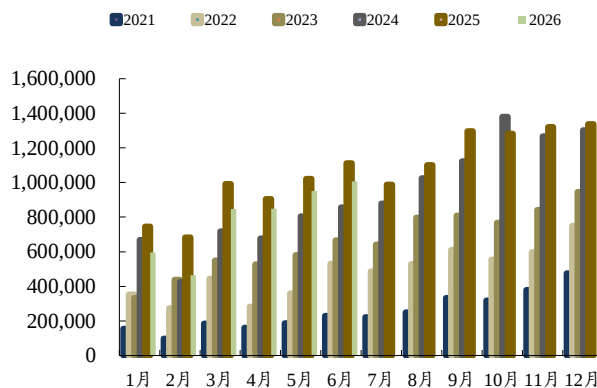
数据来源：Wind，东吴证券研究所（每年 1-2 月数据为累计值，其他月份为当月值）

图2: 2026 年 6 月制造业固定资产投资完成额累计同比-1.2%



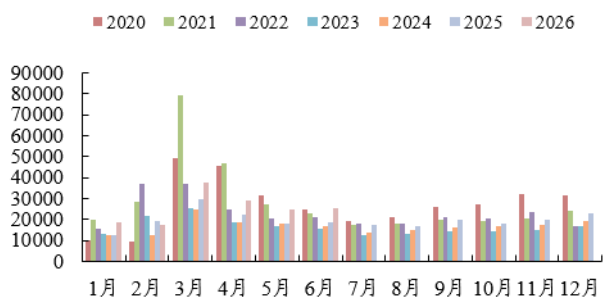
数据来源：国家统计局，东吴证券研究所

图4: 2026 年 6 月新能源乘用车销量 100.7 万辆，同比-9%（单位：辆）



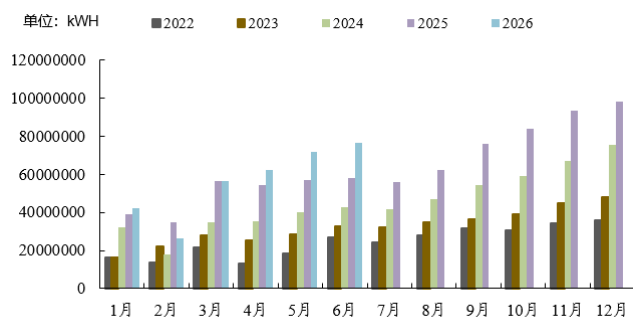
数据来源：乘联会，东吴证券研究所

图5: 2026 年 6 月挖机销量 2.5 万台,同比+35% (单位:台)



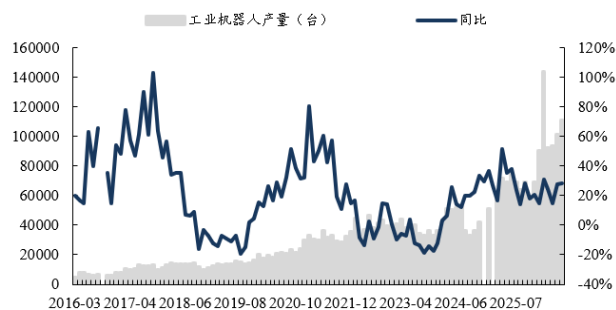
数据来源: 工程机械协会, 东吴证券研究所

图7: 2026 年 6 月动力电池装机 76.5GWh,同比+31%



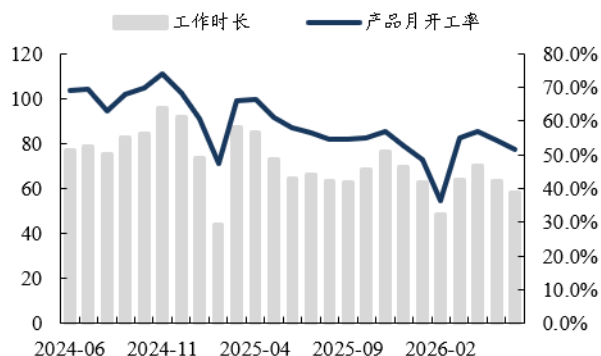
数据来源: GGII, 东吴证券研究所

图9: 2026 年 6 月工业机器人产量 11.1 万套,同比+28%



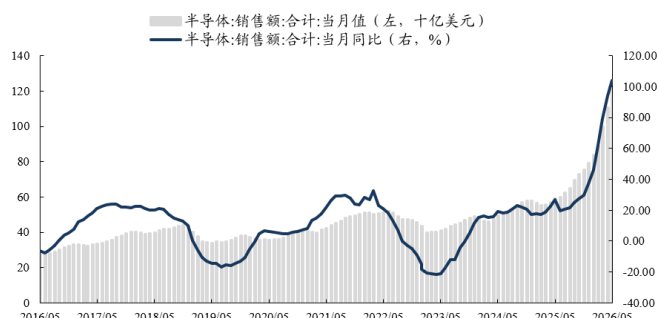
数据来源: 国家统计局, 东吴证券研究所

图6: 2026 年 6 月国内挖机开工时长为 58.1 小时, 同比-10% (单位: 小时)



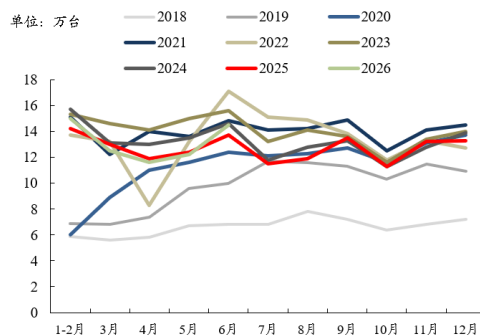
数据来源: 工程机械协会, 东吴证券研究所

图8: 2026 年 5 月全球半导体销售额 1206.1 亿美元, 同比+104%



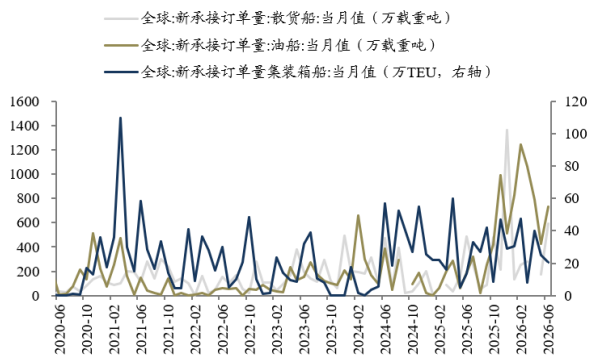
数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图10: 2026 年 6 月电梯、自动扶梯及升降机产量为 14.5 万台,同比+9%



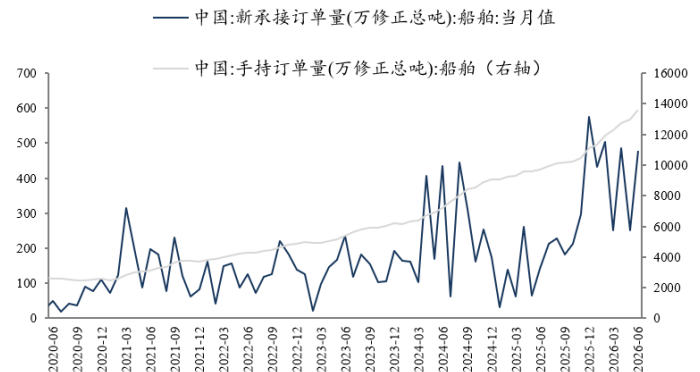
数据来源: 国家统计局, 东吴证券研究所

图11: 2026年6月全球集装箱船/油船/散货船新接单量同比分别+53%/+291%/+21%



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

图12: 2026年6月我国船舶新承接/手持订单同比分别+238%/+41%



数据来源: Wind, 东吴证券研究所

7. 风险提示

（1）下游固定资产投资不及市场预期:

制造业景气度复苏存在不及预期可能，将可能导致下游固定资产投资减少，从而影响制造业企业利润。

（2）行业周期性波动风险: 制造业存在行业周期性波动，将对制造业企业经营及股价表现造成影响。

（3）地缘政治及汇率风险: 出口系制造业重要需求来源，但在地缘政治影响下，国际关系将对企业出口造成重大影响，此外汇率波动也将对制造业企业盈利能力产生影响。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>